

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年6月23日 (23.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/056684 A1

- (51) 国際特許分類: C08K 3/00, 3/34, H05K 1/03
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/018623
- (22) 国際出願日: 2004年12月14日 (14.12.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ: 特願2003-417175
2003年12月13日 (15.12.2003) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 積水化学工業株式会社 (SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5308565 大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
(73) 発明者/出願人(米国についてのみ): 犬山晃一 (SHIRAYAMA, Koichi) [JP/JP]; 〒6188589 大阪府三島郡島本町百山2-1 積水化学工業株式会社内 Osaka (JP). 米澤光治 (YONEZAWA, Koji) [JP/JP]; 〒6188589 大阪府三島郡島本町百山2-1 積水化学工業株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 宮崎▲主税, 外 (MIYAZAKI, Chikara et al.) 〒5400012 大阪府大阪市中央区谷町1丁目6番5号 西村ビル Osaka (JP)
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): AR, BO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, NZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CT, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開客類:

- 國際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正客領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドノート」を参照。

(54) Title: THERMOPLASTIC RESIN COMPOSITION, MATERIAL FOR SUBSTRATE AND FILM FOR SUBSTRATE

A1

(54) 発明の名称: 熟可塑性樹脂組成物、基板用材料及び基板用フィルム

(57) Abstract: Disclosed is a thermoplastic resin composition which enables to obtain a molded article that is capable of maintaining the molded shape even when the article is heated after molding and is excellent in dimensional stability and heat resistance. The thermoplastic resin composition contains 100 parts by weight of a thermoplastic resin and 0.1-100 parts by weight of an inorganic compound dispersed in the thermoplastic resin. Not less than 75% of the molded shape of an article can be maintained even after the article is heated to a temperature not less than the glass transition temperature or melting point of the thermoplastic resin. Also disclosed are a material and a film for substrates composed by using such a thermoplastic resin composition.

WO 2005/056684 A1

(57) 要約: 膜型された形状を、膜型後に加熱された場合でも保持することができ、寸法安定性及び耐熱性に優れた成形品を得ることを可能とする熟可塑性樹脂組成物を得る。熟可塑性樹脂100質量部と、熟可塑性樹脂に分散された無機化合物0.1~100質量部とを含み、膜型された形状が、熟可塑性樹脂のガラス転移温度または融点以上に加熱された後でも75%以上保持される熟可塑性樹脂組成物、並びに該熟可塑性樹脂組成物を用いて構成された基板用材料及びフィルム。